

证券代码：301369

证券简称：联动科技

佛山市联动科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：投 2023-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、中金公司 张怡康； 2、高信百诺基金 闫树仁； 3、交银施罗德基金 杨茉然； 4、华创证券 王帅；
时间	2023年3月23日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书邱少媚女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司 2022 年的主要经营情况？</p> <p>回复：2022 年，公司实现营业收入 35,010.67 万元，较上年同期增长 1.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,648.35 万元，较上年同期下降 1.00%。受到半导体周期下行的影响，消费类电子相关的小信号分立器件测试系统和激光打标设备产品订单减少，导致其销量下滑较大。2022 年，为了应对市场的变化，公司持续推进科技创新，持续加大研发投入，持续对现有产品进行改良升级和研发新产品和新的应用方案，把握大功率应用领域的发展机遇，2022 年研发费用为 6,116.55 万元，较 2021 年增加 24.7%；研发投入占公司营业收入比例为 17.47%。</p> <p>2、公司半导体分立器件测试系统的主要竞争优势有哪些？</p> <p>回复：（1）公司目前已经拥有自主研发的分立器件测试系统产品包括 QT-3000/4000/6000 系列，涵盖小信号及中高功率分立器件测试，包括二极管、三极管、MOS-FET、IGBT、可控硅以及新一代半导体材料 SiC、GaN 等主流及新型分立器件，并已实现了产品的国际化布局。</p> <p>（2）多年以来，公司产品不断更新迭代，实现了产品测试功能与测试能力的多方面突破。在测试功能方面，公司的半导体分立器件测试系统除可进行常规的直流及交流参数测试外，还具有完整的动态测试功能模块覆盖，与其他设备供应商相比测试功能覆盖面更广。在测试能力方面，目前公司半导体分立器件</p>

测试系统的电压电流的测试能力已提升至 1600A/6KV, 能满足高压源、大电流源等级功率器件的测试要求, 在行业内处于领先地位。

(3) 大功率器件和第三代半导体的测试技术的重点在于高压和大电流参数方面要求较高, 对测试系统结构设计、电路设计能力、电源控制能力、电流电压过载保护能力、信号抗干扰能力、测试精度和应用经验要求较高。目前, 公司 QT-4000 系列功率半导体分立器件测试系统在功率半导体分立器件测试的细分领域中具有较强的产品竞争力。此外, 公司在 2022 年新推出 QT-8400 系列测试系统, 继续巩固公司在功率半导体分立器件测试的竞争优势。

(4) 随着制造成本的提升和合封器件的应用, 分立器件 CP 测试 (晶圆测试) 的需求逐渐增多, 为了提升测试效率, 客户对测试系统的并行测试能力不断提高。公司的 QT-4000 系列综合测试平台能够实现半导体器件直流参数测试项目和动态参数测试项的一对一数据合并, 同时能够分别实现小信号分立器件和中大功率器件的多工位并行测试要求, 带来测试精度、测试效率及数据分析管理效率的大大提高, 以适应现代化工厂对大数据质量管理 and 高效测试的需求。

(5) 公司产品的客户覆盖国内外知名的功率半导体 IDM 厂商、封测龙头企业, 上述客户采购的设备专业化程度较高, 其封测产线对于设备的工作效率、工作稳定性和供应商的技术服务保障速度具有较高要求。公司具备完善的销售网络, 能够贴近客户, 及时满足客户需求, 相较国际封测设备供应商具有更强的本土化销售及服务的优势。公司已在佛山、上海、成都、马来西亚等代表性市场区域建立起推广及服务网点, 能够覆盖华南、华东、西北、东南亚等主要市场, 快速响应客户需求、持续拓展当地业务。

3、如何看待半导体分立器件测试系统的技术发展趋势以及公司产品技术发展方向?

回复: (1) 随着新能源、电动汽车的兴起和家电行业的新应用, 功率器件逐渐模块化、集成化, 功率不断加大, 性能不断提高, 以 MOSFET 和 IGBT 为代表的功率半导体及第三代半导体呈现出高电压大电流的应用趋势, 器件的电路密度和功率密度更大, 对功率半导体测试系统的电流/电压及脉宽控制精度的测试要求不断提高; 除需要测试直流参数, 还需要测试更多范围的动态参数, 对于测试系统的功能模块要求也越来越高。

(2) 公司的研发项目主要围绕半导体自动化测试相关技术, 包括功率半导体、第三代半导体、数模混合信号和大规模数字信号集成电路测试技术, 能够更加及时、准确地掌握市场需求和技术发展趋势。其中公司在功率半导体和第三代半导体相关的测试技术方面具有深厚的技术储备和丰富的供货经验, 随着新能源汽车、光伏、风力发电、储能等行业大力发展, 功率半导

体和第三代半导体需求急剧增加,相关应用要求也不断提高,公司将深耕市场需求,持续实现产品技术的升级和迭代,保持在功率半导体分立器件测试领域领先的竞争优势。

4、公司大规模数字集成电路测试系统的研发进度?

回复:目前该产品系列正在研发验证阶段,相关产品预计于2024年推出。

5、影响公司半导体测试系统的产品定价因素有哪些?

回复:公司测试系统的价格区间较大,测试系统的销售价格首先取决于产品配置,配置越高、测试范围越大、测试能力越强,则产品定价越高。另外,公司也会根据客户开拓的需要和市场竞争状况制定具有竞争力的产品价格。

6、公司产品从发货到验收的周期多久?

回复:一般情况下,公司整机产品从发货到验收的时间为3-6个月,由于受到客户投产计划、生产进度、内部验收流程等因素的影响,发货至验收的周期也会有所波动。

7、请介绍公司与芯片设计公司的业务合作情况?

回复:由于半导体产业链垂直分工模式的形成,芯片设计、晶圆制造、封装测试等主要环节由不同的独立主体完成,存在由芯片设计企业指定下游封测企业根据芯片设计公司的需求采购测试系统的情况。因此,公司除了会与直接下游封测企业发生销售业务关系,还会主动与封测企业的上游芯片设计企业建立业务联系。与国内外竞争对手相比,我们在与封测企业的上游芯片设计企业建立业务联系的领域进入得比较晚,目前业务量及客户资源相对较少,整体业务规模和技术水平还需要进一步提升,客户基础相对薄弱,行业渗透度不高。

随着近几年公司产品团队的产品应用经验的进一步积累和丰富,技术方案储备更能对接目标客群的高技术性和专业化的需求,以及公司上市后募投项目的逐步推进,可调配资源增加,公司未来也将逐步加大该业务领域的技术和资源投入,并加大有关销售人员的招聘力度,持续开拓新客户和新市场。

8、请介绍公司的研发模式?

回复:公司设立以来一直坚持自主研发的模式。半导体专用设备制造业属于资金密集型、技术密集型产业,技术壁垒较高,研发周期较长的特点。企业通过自主研发掌握的核心技术,能够形成难以模仿的核心竞争力。同时,自主研发所获得的技术成果,能够使企业无需依赖于外部技术支持,受外部因素影响的技术风险较小。因此,公司坚持自主研发的研发模式将使公司可依靠自身的核心技术保持公司在市场中较强的竞争力,尤其在市场差异化竞争中保持优势,有利于公司未来的可持续发展。

附件清单（如有）	无
日期	2023年3月24日